

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-1

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件：参会投资者清单。
时间	2026年2月25日-3月3日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	董事长 曹建伟 投资者关系 林婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司光伏业务的布局？</p> <p>答：公司作为全球技术和规模双领先的光伏设备供应商，业务覆盖光伏全产业链关键装备、核心耗材及智能工厂整体解决方案，致力于为客户提供具备全球竞争力的产品与服务。在光伏装备端，公司产品覆盖硅片、电池、组件全环节，可提供整线解决方案，具体包括晶体生长、加工、电池工艺（如 PECVD、ALD）及去银化组件设备等关键设备。在光伏耗材端，公司石英坩埚实现技术规模双领先；金刚线产品在切割效率与稳定性上表现突出，并已实现高品质钨丝金刚线量产。在智能制造端，公司通过装备的数字化与智能化联通，为客户提供自动化、数字化的智能工厂解决方案，助力其降本增效。</p> <p>2、请介绍一下在光伏装备端，公司具体有哪些产品布局？</p> <p>答：在光伏装备领域，公司产品覆盖了硅片、电池和组件环节，为客户提供光伏整线解决方案。硅片制造端，公司的主要产品有全自动晶体生长设备（单晶硅生长炉）、晶体加工设备（环线截断机、环形金刚线开方机、滚圆磨面一体机、金刚线切片机）、晶片加工</p>

设备（脱胶插片清洗一体机）、晶片分选检测设备；在电池端，公司开发 PECVD、扩散、退火、单腔室多舟 ALD 和电池切割边缘钝化（EPD）设备等多种电池工艺设备；在组件端，公司开发了含排版机、边框自动上料机、灌胶检测仪等多道工序的组件设备产线。同时，通过实现各装备间的数字化和智能化联通，向客户提供自动化+数字化的智能工厂解决方案，促进客户生产效率提升，实现降本增效。

公司单晶硅生长炉在光伏行业实现了技术和规模双领先，切片机、脱胶插片清洗一体机以及分选装盒一体机以创新的设计和工艺，实现了生产效率和质量的大幅提升；差异化设计和工艺的电池设备，在稳定性、均匀性以及效率等方面表现优异，得到客户的广泛认可；创新的去银化组件设备，能够大幅降低电池及组件环节的银耗，大幅降低组件生产成本。

3、请问公司碳化硅衬底业务的进展？

答：公司碳化硅衬底材料业务已实现 6-8 英寸碳化硅衬底规模化量产与销售，量产的碳化硅衬底核心参数指标达到行业一流水平，8 英寸碳化硅衬底技术和规模处于国内前列，公司积极推进碳化硅衬底在全球的客户验证，送样客户范围大幅提升，产品验证进展顺利，并成功获取部分国际客户批量订单。同时公司首条 12 英寸碳化硅衬底加工中试线已正式通线。

4、请问公司 12 英寸碳化硅衬底材料的进展？

答：2025 年 9 月，公司首条 12 英寸碳化硅衬底加工中试线在子公司浙江晶瑞 SuperSiC 正式通线，至此，子公司浙江晶瑞 SuperSiC 真正实现了从晶体生长、加工到检测环节的全线设备自主研发，100%国产化，标志着晶盛在全球 SiC 衬底技术从并跑向领跑迈进，迈入高效智造新阶段。今年 1 月份，依托自主搭建的 12 英寸中试线，浙江晶瑞 SuperSiC 成功实现 12 英寸碳化硅衬底厚度均匀

性 (TTV) $\leq 1 \mu\text{m}$ 的关键技术突破；这是继建成行业首条 12 英寸碳化硅中试线后，晶盛机电研发中心与浙江晶瑞 SuperSiC 联手取得的又一重大成果，充分彰显了晶盛机电“装备+材料”协同创新的核心优势。

5、请问公司碳化硅衬底材料的产能布局？

答：公司积极布局碳化硅产能，在上虞布局年产 30 万片碳化硅衬底项目；并基于全球碳化硅产业的良好发展前景和广阔市场，在马来西亚槟城投建 8 英寸碳化硅衬底产业化项目，进一步强化公司在全球市场的供应能力；同时，在银川投建年产 60 万片 8 英寸碳化硅衬底片配套晶体项目，不断强化公司在碳化硅衬底材料领域的技术和规模优势。

6、请问公司半导体装备业务进展？

答：公司依托半导体装备国产替代的行业发展趋势和机遇，积极推进半导体装备的市场推广。

在集成电路装备领域，公司自主研发的 12 英寸常压硅外延设备顺利交付国内头部客户，其电阻率、厚度均匀性、外延层缺陷密度、生产效率以及工艺重复性等关键指标达到国际先进水平。积极推进 12 英寸干进干出边抛机、12 英寸双面减薄机等新产品的客户验证。12 英寸硅减压外延生长设备顺利实现销售出货，设备采用单温区、多温区闭环控温模式，结合多真空区间精准控压技术，确保外延生长过程的高度稳定性，其独特的扁平腔体结构和多口分流系统设计，能够显著提升外延层的膜厚均匀性和掺杂均匀性，满足先进制程的高标准要求。成功开发应用于先进封装的超快紫外激光开槽设备，填补国内高端紫外激光开槽技术领域的空白，实现国产替代。

在化合物半导体装备领域，公司紧抓碳化硅产业链向 8 英寸转移的行业发展趋势，充分发挥在碳化硅产业链装备的核心技术优势，加强 8 英寸碳化硅外延设备以及 6-8 英寸碳化硅减薄设备的市场推

	广，积极推进碳化硅氧化炉、激活炉以及离子注入等设备的客户验证，相关设备的市场工作进展顺利，为规模化量产奠定坚实基础。
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2026年2月25日-3月3日

参会投资者清单

序号	公司
1	易方达基金
2	嘉实基金
3	平安资管
4	中邮基金
5	鑫元基金
6	准锦投资
7	上海金恩
8	中信证券
9	长江证券
10	浙商证券
11	中银证券
12	兴业证券
13	长城证券
14	东财证券
15	方正证券